2021-半導體真空鍍膜技術與 Macleod 薄膜設計研討會

源 由: 真空鍍膜技術的發展，攸關國家科技的進步，全球重要半導體元件都需要真空鍍膜技術的支援，近年來台灣在半導體製程與 IC 封裝產業上，都有創新與嶄新的技術發展，更是需要真空鍍膜技術與薄膜模擬設計的技術發展配合，因此舉辦一場半導體真空鍍膜技術與 Macleod 薄膜設計研討會。研討會中很榮幸邀請國家實驗研究院儀器科技研究中心、國立中央大學與業界專家說明最新發展真空鍍膜技術應用於電漿製鍍薄膜技術開發介紹、單層原子沉積與蝕刻(ALD & ALE)在半導體製程技術開發、第三代半導體 GaN 材料技術發展、光學薄膜量測與 Macleod 薄膜模擬設計與上機實作等，都是應用在半導體元件製程技術發展上。上午期間第一場邀請到國研院儀科中心\鍍膜元件組廖博士研究員演講關於儀科中心發展 PVD 真空鍍膜技術應用於光學薄膜。第二場將邀請國研院儀科中心\ ALD 製程暨設備發展組卓副研究員演講關於 ALD & ALE 製程技術開發與應用介紹。下午期間第一場邀請到國立中央大學光電與工程學系陳特聘教授介紹第三代半導體 GaN 材料技術的發展。第二場邀請到宗豪科技股份有限公司蘇先生講授光學薄膜量測原理與 Macleod 光學模擬軟體基礎操作及上機實作，並且演習實際案例設計說明，希望參與研討會人員都能夠獲得半導體真空鍍膜與薄膜設計的實務經驗。最後感謝雲林科技大學的**高教深耕計畫中心、教學卓越中心、電子工程系、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心、國立中央大學光電與工程學系**與**宗豪科技股份有限公司**的全力支援。

時 間: 109.09.10 (週五)

地 點: 國立雲林科技大學 演講在工程五館 EB107 演講廳與上機實作在工程三館 ES302 電腦教室(均採梅花座位，如因疫情影響將改為線上會議)。

主辦單位: 雲科大高教深耕計畫中心、教學卓越中心、雲科大電子工程系。

協辦單位: 宗豪科技股份有限公司

人 數: 40 人

費 用: Free (中午供餐)

報名方式 : 9/8(三)PM17:00 報名截止，採網路報名。

報名網址 : https://webapp.yuntech.edu.tw/Activities/Activities/Details?activityID=47902

聯絡人: 李日竣同學 E-mail: m10913030@yuntech.edu.tw TEL:(05)5342601 ext 4373

議程時間表:

時間	單位	講員	講題
08:30-08:50	報到		
08:50-09:00	長官致詞 (工程學院 王院長)		
09:00-10:30	國研院儀器中心\真空鍍膜與光學元件組	廖 博 輝 研究員	PVD 真空鍍膜技術應用於光學薄膜
10:40-12:10	國研院儀器中心\ ALD 製程暨設備發展組	卓 文 浩 副研究員	ALD / ALE 技術發展與應用
12:10-13:00	午休 (用餐時間 ES102)		
13:10-14:40	國立中央大學/光電與工程學系	陳 昇 暉 特聘教授	第三代半導體 **GaN** 材料技術發展
15:00-16:50	宗豪科技股份有限公司	蘇 朝 盈 講師	光學薄膜量測原理與 Macleod 薄膜設計軟體實作